联讯仪器 20260902

联讯仪器：1.6T 测试方案全球稀缺，2026Q2 净利率跳升验证盈利拐点

摘要

- 2026Q2 利润达 4.5 亿元，环比 Q1 的 1.2 亿元大幅扩张，净利率由 20%+跃升至 43%。
- 盈利超预期主因 1.6T 光模块测试用 65GHz 示波器等高端产品规模化放量，带动毛利结构优化。
- 公司为全球唯二提供 1.6T 全套测试方案厂商，目前全球市占率仅 10%，具备巨大提升空间。
- 技术迭代引发测试需求“通胀”，800G 升级至 1.6T 需更高带宽设备，提升单价与技术壁垒。
- 光芯片测试需求随光模块扩产呈倍数级增长，公司在 KGD、COC 测试环节占据重要地位。
- 横向拓展存储测试领域，聚焦高速 FT 存储测试机，已进入 IPO 募投计划并推进顺畅。
- 前瞻布局 CPO 及 NPO 测试能力，已在 OEE 测试环节取得进展，确保技术演进中的竞争力。

Q&A

如何理解联讯仪器当前的核心定位与业绩表现，特别是 2026 年第二季度财务数据所反映出的盈利能力变化？

联讯仪器当前的核心定位可类比为早期的安捷伦，其增长逻辑主要建立在光测试与存储测试两大业务板块。具体来看，光模块、光芯片及硅光晶圆的测试是其现阶段核心的放量产品，同时公司也在积极布局存储领域的测试业务。 从近期业绩表现分析，2026 年第二季度的财务数据尤为突出。相较于第一季度约 1.2 亿元的利润，第二季度利润达到了近 4.5 亿元，实现了大幅扩张。这一增长背后最核心的驱动力是公司盈利能力的超预期提升。数据显示，公司净利率从第一季度

的 20%以上水平，显著跃升至第二季度的 43%。这种盈利能力的提升主要归因于高端产品的放量，特别是 1.6T 光模块测试所需的 65GHz 示波器等产品的规模化销售。可以预见，随着 1.6T 产品订单的持续释放和占比提升，以及未来 NPO 相关需求的出现，高端产品将持续推动公司整体利润端的加速增长，净利率有望维持在较高水平。

联讯仪器作为一家成立时间不长的公司，为何能迅速成长为行业领先者，并展现出强大的技术拓展能力？

联讯仪器之所以能够迅速取得市场领先地位并展现出强大的业绩表现，其核心原因在于公司创始团队的技术背景和行业积累。公司的高管团队成员大多拥有在前安捷伦、菲尼萨等全球头部光通信公司超过十年的资深技术背景。这种深厚的技术基因和经验积累，是公司创立后能够持续实现技术突破和产品快速迭代的根本支撑。这不仅解释了公司在光测试领域的成功，也说明了其为何有能力将业务拓展至电测试领域的存储测试机，并取得相应进展。这种由核心团队基因引领的技术驱动型发展模式，是公司快速成长的关键。

从行业资本开支和技术迭代的角度看，联讯仪器在光通信产业链中扮演着怎样的角色？其业务增长的确定性体现在哪些方面？

在当前光通信行业的扩产周期中，联讯仪器扮演着“最大公约数”的角色，其增长确定性极高。分析产业链上下游可以发现，无论是国内的旭创科技、新易盛，还是海外的 Coherent、Lumentum、AOI 等核心客户，在 2026 年第二季度均表现出持续加速的资本开支。这些资本开支的核心投向之一便是测试仪器。 具体来看，无论是 800G 光模块的持续扩产，还是向 1.6T、6.4T NPO 等更高速率产品的升级，测试仪器都是必不可少的环节，且光模块与 NPO 的生产普遍要求全检，这确保了对测试设备的刚性需求。更重要的是，技术迭代带来了测试需求的“通胀”效应。例如，从 800G 升级到 1.6T，测试所用的核心设备需要从 50GHz 带宽的采样示波器升级为 65GHz 带宽的产品，这种升级不仅带来了设备单价的提升，也因技术壁垒的提高增强了产品的盈利能力。这一逻辑已在公司 2026 年第二季度 43%的净利率中得到验证。展望未来，随着 3.2T NPO 等更高端产品的逐步量产，测试需求的持续通胀将为公司带来确定的增长动力。

在光模块扩产的背景下，光芯片测试市场呈现出怎样的发展趋势？联讯仪器在该领域的市场地位和增长前景如何？

随着光模块产业的持续扩产，上游光芯片的测试需求正迎来倍数级增长。无论是采用硅光方案还是 EML 方案，光模块的生产都需要配套多个光芯片，这意味着光芯片的测试需求量是光模块数量的数倍。具体到测试环节，包括 KGD（Known Good Die）和 COC（Chip on Carrier）在内的测试需求都在随之扩张。联讯仪器在 KGD 和 COC 测试市场中占据重要地位，将直接受益于整个板块需求的快速增长。随着市场规模的扩大，公司有望展现出规模效应，从而带动该业务板块利润的加速兑

现。因此，光芯片测试市场的扩张是公司未来重要的增长点之一。

如何评估联讯在光模块测试领域的市场地位、核心竞争力及其未来的业绩增长预期？

联讯的业绩有望持续高速增长。其核心业务聚焦于光模块测试环节，当前的市场定位是全球唯二能够提供 1.6T 全套测试解决方案的公司之一，该方案已通过客户验证并进入放量阶段。这一市场地位使其能够充分受益于 2026 年和 2027 年 1.6T 产品的规模化放量，以及未来 NPO（Near Packaged Optics）的增长趋势。业绩增长的核心支撑逻辑主要有三点： 第一，整个行业正处于资本开支加速的阶段。 第二，联讯的 1.6T 整体解决方案具备全球稀缺性，技术能力领先。 第三，公司目前在全球相关领域的市场占有率仅为 10%左右，在产品技术达标并进入放量元年的背景下，市占率有巨大的提升空间。 这三个因素的共振，是其第二季度业绩加速以及未来业绩有望持续释放的基础。

除了光模块测试业务，联讯在光器件领域的布局和增长前景如何？

在光器件领域，联讯主要布局上游的光芯片相关业务，具体包括光芯片的 KGD（Known Good Die）和 COC（Chip on Carrier）的老化与测试。公司凭借其在光测量领域的核心能力，成功切入这一上游环节。随着下游光模块厂商的大规模扩产，上游光芯片环节同样受益于整个行业的扩张周期，呈现出显著的增长态势。从下游反馈来看，联讯在该领域的市场占有率和竞争力均表现强劲，订单增长非常迅速。整体而言，联讯通过卡位光芯片的 PICD、COC 测试以及中游光模块测试，全面受益于 1.6T 产品的放量周期。随着高端产品在其收入结构中占比的提升，公司整体的利润释放有望持续超出市场预期。

联讯在存储测试设备领域的业务布局、当前进展及未来潜力是怎样的？

联讯的业务布局不止于光通信领域，在存储测试方面也进行了重要拓展，主要聚焦于高速 FT（Final Test）存储测试机。该设备主要用于存储芯片完成封装后的整体性能测试。公司的 IPO 募投项目中就包含了存储测试设备的扩张计划，显示了其在该领域的战略决心。目前，该业务的产品推进状况非常顺畅，下游客户的拓展也按计划进行，其能力建设和业务进展可能超出市场预期。长期来看，该业务有望为公司注入强大的增长动力，未来不仅局限于国内市场，更有机会拓展至长鑫存储、海力士等全球主要客户。

面对 CPO 等新兴技术趋势，联讯在测试领域有何应对和布局？

公司已预见到 CPO（Co-Packaged Optics）等技术演进对测试环节带来的
并积极进行相关能力建设。目前，公司在 CPO 相关的测试能力搭建上已取
例如在 Insertion 3 的 OEE（Optical Electrical Electrical）测试环
相关成果，同时 Insertion 2 的推进工作也在进行中。作为一家兼具光、

人在草木间

能力的公司，联讯对未来的技术发展路线有清晰的布局，以确保其在行业技术变革中保持竞争力。